

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 5月10日
【会社名】	日立電線株式会社
【英訳名】	Hitachi Cable, Ltd.
【代表者の役職氏名】	執行役社長 高橋 秀明
【本店の所在の場所】	東京都台東区浅草橋一丁目22番16号
【電話番号】	(03)6381-1045
【事務連絡者氏名】	ビジネスサポート本部法務部長 吉岡 勇士
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区浅草橋一丁目22番16号
【電話番号】	(03)6381-1045
【事務連絡者氏名】	ビジネスサポート本部法務部長 吉岡 勇士
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成24年10月29日付で、住友金属鉱山株式会社（以下「住友金属鉱山」といいます。）が設立する子会社（以下「本新設会社」といいます。）に対して、当社のリードフレーム事業を会社分割（吸収分割）の方法により承継させるとともに、住友金属鉱山から本新設会社の株式の譲渡を受けることにより本新設会社の株式の49%を保有することとなる契約を締結する旨の決議について、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき臨時報告書を提出し、また、平成25年1月31日付で臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。それらの記載事項の一部に変更が生じたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正内容】

訂正箇所は_____線で示しております。

2 [報告内容]

(訂正前)

(前略)

(3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(中略)

② 吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会	未定
吸収分割契約書締結日	未定
吸収分割契約承認株主総会	未定（本新設会社）
本吸収分割の効力発生日	未定

(注1) 住友金属鉱山は、本吸収分割に先立ち、住友金属鉱山の完全子会社として、リードフレーム事業の受皿会社（承継会社）となる本新設会社を設立いたしました（本新設会社の設立年月日は平成25年1月7日です。）。

(注2) 分割会社である当社においては、会社法第784条第3項に規定する簡易吸収分割に該当するため、吸収分割契約承認株主総会を開催いたしません。

(注3) 本吸収分割の効力発生日と同日付で、住友金属鉱山から当社への本新設会社株式の譲渡が予定されております。

(中略)

(5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	SHマテリアル株式会社
本店の所在地	東京都港区新橋5丁目11番3号
代表者の氏名	未定
資本金の額	1,000百万円（予定）
純資産の額	8,090百万円（予定）
総資産の額	10,815百万円（予定）
事業の内容	リードフレーム製品及び関連製品の製造・販売

(注) 上記純資産の額及び総資産の額は、平成24年3月31日現在の貸借対照表を基準に算出しているため、実際の金額は上記金額と異なる可能性があります。

(訂正後)

(前略)

(3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(中略)

② 吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会	<u>平成25年5月10日（当社、本新設会社）</u>
吸収分割契約書締結日	<u>平成25年5月10日</u>
吸収分割契約承認株主総会	<u>平成25年5月17日（本新設会社）</u>
本吸収分割の効力発生日	<u>平成25年7月1日（予定）</u>

(注1) 住友金属鉱山は、本吸収分割に先立ち、住友金属鉱山の完全子会社として、リードフレーム事業の受皿会社（承継会社）となる本新設会社を設立いたしました（本新設会社の設立年月日は平成25年1月7日です。）。

(注2) 本新設会社は取締役会非設置会社であるため、吸収分割契約の承認に関して、取締役社長の決定

をもって機関決定いたしました。

(注3) 分割会社である当社においては、会社法第784条第3項に規定する簡易吸収分割に該当するため、吸収分割契約承認株主総会を開催いたしません。

(注4) 当社は、吸収分割契約の承認に関して、取締役会の委任を受けた執行役社長の決定をもって機関決定いたしました。

(注5) 本吸収分割の効力発生日と同日付で、住友金属鉱山から当社への本新設会社株式の譲渡が予定されております。

(中略)

(5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	S Hマテリアル株式会社
本店の所在地	東京都港区新橋5丁目11番3号
代表者の氏名	<u>代表取締役社長 野口 周治</u>
資本金の額	1,000百万円 (予定)
純資産の額	8,090百万円 (予定)
総資産の額	10,815百万円 (予定)
事業の内容	リードフレーム製品及び関連製品の製造・販売

(注) 上記純資産の額及び総資産の額は、平成24年3月31日現在の貸借対照表を基準に算出しているため、実際の金額は上記金額と異なる可能性があります。

以 上